

2018年1月29日

報道関係各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会

JEITA 半導体部会、災害に備える体制構築で顧客と社会の発展に貢献 地震対策のための半導体工場向け技術事例集を作成

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の半導体部会（部会長：ルネサス エレクトロニクス株式会社 代表取締役会長 鶴丸 哲哉）は、本日、半導体部会加盟各社の技術・ノウハウを集積した「地震対策技術事例集」を作成したことを発表しました。

JEITA 半導体部会は、東日本大震災や熊本地震などの教訓から、2016年8月に半導体部会内に Business Continuity Management - Task Force (BCM-TF) を結成し、災害への備えと災害発生時の協力体制の構築に関する検討を続けてまいりました。BCM-TF では、災害に対する備えとして、半導体工場の耐震強化技術という協調領域に着目し、今回、各社の技術・ノウハウを集積した地震対策技術事例集を作成しました。本事例集は BCM-TF 加盟企業間および各社の取引企業で共有するものとし、生産工場のハードウェアおよびマネジメントにおける事例を取りまとめ、過去の震災における被害や対策事例、設備の耐震強化施策および情報共有の手法などを掲載しています。各社が持つ経験や知見・技術を共有することで、災害に対する有効な備えの強化を促し、さらに今後は本事例集に基づいたセミナーを関連企業に対して実施することで、周知・共有を徹底していく予定です。

また、本日、半導体部会に加盟する 12 社が、災害時における相互協力を合意しました。本合意は地震やその他の災害により被害を受けた場合に、半導体業界として連携および協力する体制を明確にすることで、製品供給の継続に努め、顧客および社会の発展に貢献するものです。

JEITA は業界団体として、健全な競争を尊重しつつ、災害発生時などの緊急対応時における協調体制を構築することで、顧客および社会に貢献し、業界の発展に繋げてまいります。今後の取り組みにつきましては、随時発表いたします。

【本件に関する企業/団体からのお問い合わせ先】

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）電子デバイス部（担当：井上）
TEL：03-5218-1061 E-mail：sspg@jeita.or.jp

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）総合企画部 広報室（担当：吉田）
TEL：03-5218-1053 E-mail：press@jeita.or.jp